

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2026-015

## 沪士电子股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年2月7日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第十四次会议（临时会议）通知。会议于2026年2月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，其中陈梅芳女士、吴传彬先生、官锦堃先生、高启全先生、王永翠女士、张进先生以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于新建高端印制电路板生产项目的议案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司战略规划及实际经营情况，经公司董事会战略与ESG委员会提议，同意投资新建“高端印制电路板生产项目”（下称“本项目”），生产高层数、高频高速、高密度互连、高通流PCB，以满足高速运算服务器、下一代高速网络交换机等对高端印制电路板的中长期增量需求。同意竞拍约66,678.4平方米土地使用权以实施本项目，本项目建设期为2年，总投资约为33亿元人民币，建成后预计年新增产能14万平方米高端印制电路板的生产规模，预计年新增营业收入30.5亿元人民币。同意授权管理层或其授权代表签署相关法律文件并全权办理本项目实施事宜；同意授权管理层根据市场环境、技术发展趋势、市场需求变化等

具体情况，对本项目的投资总额（在30%的幅度范围内）、项目进程、市场定位等具体规划进行调整，以提高本项目的竞争力和适应性。

本项目是基于公司战略规划及经营需要做出的决定，有一定的建设周期，但市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。本项目投资总额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

《关于新建高端印制电路板生产项目的公告》详见2026年2月13日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会  
二〇二六年二月十三日